

ペーストを介在させ、接合信頼性を向上

Interposes paste to raise bonding reliability

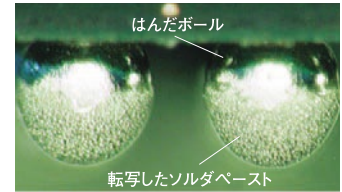
ECO SOLDER® PASTE

M705-TVA-HF ~転写用ペースト~

印刷困難な箇所に実装可能、優れた大気リフロー性

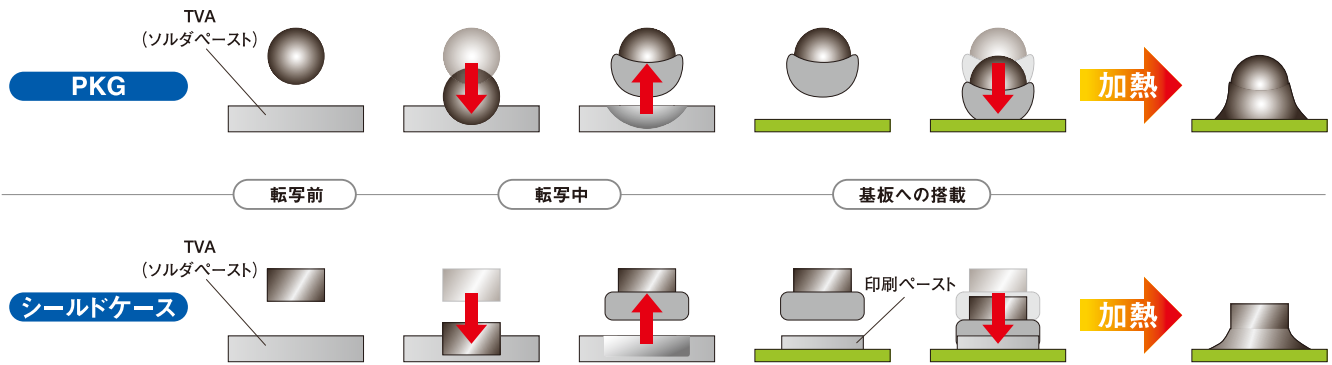
特長

- ペースト特性を改善し、一定量はんだ転写が可能。
- 良好な転写性、膜厚の定量化が可能ではんだの量の制御が容易。
- 凸凹部など印刷困難な箇所での転写を実現。



製品仕様

転写例



ペーストとフラックス転写の比較

ボールにペーストを転写することで、フラックスの転写と比較して未融合不良を低減

